

中信证券股份有限公司
关于厦门优迅芯片股份有限公司
2026 年半年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称“优迅股份”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订承销及保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2026 年 8 月 24 日至 2026 年 8 月 25 日对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、股东会和董事会议事规则等公司治理制度、股东会和董事会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、资金管理、内部审计等内部控制制度；

（3）查阅公司与实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件；

（4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、公司出具的 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告；

- (5) 对公司高级管理人员进行访谈；
- (6) 对公司及其实际控制人、董事、高级管理人员进行公开信息查询；
- (7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；
- (8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

根据公司 2026 年半年度报告，主要的风险事项如下：

（一）核心竞争力风险

1、产品研发及技术迭代风险

集成电路设计行业技术密集且迭代迅速，新技术、新产品持续涌现。公司需持续投入资源升级现有产品、研发新技术与新产品，以维持技术先进性与产品竞争力。若公司对行业技术趋势判断失误、募集资金投资项目或新产品规划偏离下游需求，或研发效果不及预期、技术迭代滞后，将导致产品无法满足市场需求，丧失技术优势，影响盈利能力与持续发展。

2、知识产权泄露与侵权风险

核心技术与知识产权是公司核心竞争力，公司已积累大量自主研发核心技术与专利。尽管公司建立严格保密制度，但仍可能因员工疏漏、外界窃取等导致核心技术泄密；同时，若公司与第三方产生知识产权纠纷，或因员工、合作伙伴对知识产权理解偏差导致侵权，将对业务发展与经营业绩造成不利影响。

3、关键技术人才流失风险

关键技术人员是集成电路设计企业保持竞争优势与持续创新的核心资源。随着行业快速发展，技术人才竞争加剧，若关键技术人员离职，将直接影响产品研

发进度与公司整体研发能力，对技术迭代与产品竞争力造成冲击。

（二）经营风险

1、供应链稳定性风险

公司采用 Fabless 模式经营，核心依赖晶圆代工厂与封测厂的生产服务。集成电路行业中，晶圆代工厂与封测厂属于重资产行业，市场集中度高。报告期内，公司向前五大供应商采购金额占比为 75.33%，供应商集中度较高。若未来国际政治经济形势变动、下游需求波动或半导体产业链格局调整，导致晶圆及封测产能紧张、断供或采购价格大幅上涨，将造成公司产品交货延迟或成本激增，影响生产经营。

2、产品质量风险

芯片产品作为光通信模组核心器件，对批量生产的稳定性与可靠性要求极高。由于芯片产品结构复杂，公司无法完全规避质量缺陷风险。若产品出现质量问题，不仅需承担赔偿责任，还将损害品牌形象与客户关系，对经营业绩与市场声誉造成双重负面影响。

3、经营规模较小风险

报告期内，公司营业收入为 29,745.05 万元，经营规模与 Macom、Semtech 等国际龙头企业存在较大差距。公司业务聚焦光通信电芯片领域，产品结构相对单一，相较于业务多元的国际厂商，抗行业波动能力较弱。若宏观经济形势、行业政策、下游需求或自身经营管理、技术研发出现重大不利变化，将对整体经营产生显著冲击。

（三）行业风险

1、市场竞争风险

国内集成电路设计行业快速发展，行业吸引力吸引众多新进入者，现有厂商亦加速市场拓展，市场竞争日趋激烈。若公司未能精准把握技术发展趋势与客户需求变化，无法持续实现技术、产品与服务创新，可能丧失现有竞争优势，对持续盈利能力造成不利影响。

2、产业政策风险

集成电路行业为国家战略性产业，其发展高度依赖产业政策支持。若未来国家相关鼓励政策（如研发补贴、税收优惠、市场引导等）支持力度减弱或调整，将对公司研发投入、市场拓展及盈利能力产生一定影响。

（四）宏观环境风险

集成电路产业高度全球化，公司上游晶圆、EDA 软件、测试设备等核心供应商多为境外企业。若国际贸易摩擦加剧，可能导致进口关税上升，直接增加采购成本；极端情况下，境外采购渠道受阻将中断生产供应链。同时，下游直接客户及终端客户受贸易摩擦影响需求萎缩，将间接冲击公司经营业绩。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2026 年 1-6 月，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	29,745.05	23,849.87	24.72
归属于上市公司股东的净利润	6,017.72	4,695.88	28.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,473.26	4,168.69	31.29
经营活动产生的现金流量净额	5,464.41	9,047.10	-39.60
主要会计数据	2026 年 6 月末	2025 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	180,818.46	176,591.06	2.39
总资产	188,838.22	187,053.39	0.95
主要财务指标	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元 / 股）	0.75	0.78	-3.85
稀释每股收益（元 / 股）	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.68	0.69	-1.45

加权平均净资产收益率（%）	3.34	6.23	减少 2.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.04	5.53	减少 2.49 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	14.42	15.81	减少 1.39 个百分点

2026 年 1-6 月，公司实现营业收入 29,745.05 万元，较上年同期增长 24.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,017.72 万元，较上年同期增长 28.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,473.26 万元，较上年同期增长 31.29%。上述指标变动主要系主营业务影响。公司报告期内业绩延续上年增长态势，主要受益于行业需求持续景气：（1）接入网领域，国内运营商持续推进 FTTR 规模化部署，千兆宽带持续升级，公司紧抓宽带网络升级契机，相关产品市场需求持续释放，推动接入网业务收入稳步提升；（2）数据中心及无线接入领域，持续推动 25G、100G 等产品在相关应用场景中的市场拓展，保持数据中心及无线接入领域产品稳健增长。在上述有利因素共同推动下，公司主营业务收入保持稳步增长，盈利水平同步提升。

2026 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额 5,464.41 万元，较上年同期减少 39.60%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增幅大于销售商品、提供劳务收到的现金增幅所致。

六、核心竞争力的变化情况

根据公司 2026 年半年度报告，核心竞争力情况如下：

（一）公司的核心竞争力

公司作为国内光通信电芯片领域领军企业、国家级制造业单项冠军企业，核心竞争力依托技术、产品、供应链、品控服务及市场地位多维度体系化构建，形成“技术+产品+生态”的协同竞争优势，具体体现在以下方面：

1、技术研发与知识产权优势：坚持正向设计路线，形成覆盖光通信电芯片设计全链条的 7 大核心技术集群，掌握双工艺设计和集成研发能力，具备全速率超高速芯片设计经验。截至 2026 年 6 月 30 日，拥有知识产权 167 项，其中发明专利 88 项、实用新型专利 30 项、软件著作权 8 项、集成电路布图设计 41 项，独立或牵头承担多项国家级科研攻关项目。推行“量产一代、研发一代、储备一

代”策略，巩固中低速率产品优势的同时，前瞻布局高端及终端侧新产品，技术迭代紧跟行业趋势。

2、产品与解决方案优势：产品覆盖光通信收发合一芯片等核心品类，可提供从低速率到高速率、单一芯片到系统套片的完整解决方案。以市场为导向开展研发，产品贴合客户实际应用需求，具备场景适配的差异化优势；10Gbps 及以下速率产品市占率中国第一、世界第二，25Gbps 及以上高速率产品部分关键参数优于竞品，产品高集成、低功耗且稳定性经长期市场验证。

3、品控与客户服务优势：建立贯穿产品全流程的严格品控体系，多环节测试保障产品稳定性，失效率内部控制标准远低于行业常规要求。提供端到端“交钥匙”服务，芯片设计阶段即结合应用场景优化，配套提供固件开发、产测调试软件等服务，助力客户快速量产，大幅提升客户合作粘性。

4、市场地位与行业资源优势：公司作为国内光通信电芯片龙头企业，下游客户覆盖国内外主流运营商、设备商及光模块厂商，客户群体优质稳定；参与制定 23 项国家及行业标准，拥有多项国家级资质，六次获“中国芯”奖项，行业影响力与品牌认可度高。

综上，公司以全链条核心技术与前瞻研发为根基，以全系列产品与差异化解决方案为载体，通过多元化供应链、严格品控与全流程服务筑牢客户粘性，依托细分市场领先地位与优质行业资源形成竞争壁垒。未来随着高速率产品研发落地及终端侧市场拓展，公司核心竞争力将持续强化，进一步提升国产光通信电芯片在全球产业链中的地位。

（二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

单位：万元

项目	2026年1-6月	2025年1-6月	变化幅度(%)
费用化研发投入	4,288.40	3,770.03	13.75
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	4,288.40	3,770.03	13.75
研发投入总额占营业收入比例(%)	14.42	15.81	减少1.39个百分点
研发投入资本化的比重(%)	-	-	-

2026年1-6月，公司研发投入整体保持稳定。

(二) 研发进展

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	128GBaud 相干驱动器与跨阻放大器集成技术验证芯片	2,700.00	162.29	1,984.85	持续开发	实现产业化	国内领先	骨干网，数据中心
2	FMCW Lidar 技术验证芯片	3,607.00	202.69	3,106.95	持续开发	技术预研	国际一流	激光雷达、传感、量子通信领域
3	4x28Gbps 低功耗带 CDR DFB 激光驱动器芯片	2,491.60	233.81	1,140.09	小批量阶段	实现产业化	国内先进	数据中心、4G/5G无线领域
4	50Gbaud 线性跨阻放大器芯片	1,340.00	180.67	867.89	芯片样片阶段。	实现产业化	国内先进	接入网
5	50Gbps 非对称突发模式收发合一芯片	2,900.00	5.49	731.67	芯片设计阶段	实现产业化	国内领先，国际先进	接入网
6	400G LPO PAM4 线性收发芯片	2,670.00	619.20	1,821.94	芯片样片阶段。	实现产业化	国内先进	数据中心、AI 算力领域
7	50Gbps 非对称 OLT 收发芯片	2,593.00	460.94	1,599.08	芯片样片阶段	实现产业化	国内领先，国际先进	接入网
8	2.5Gbps 带 AGC 和 RSSI 功能的突发模式跨阻放大器	315.00	87.32	187.23	样品阶段	实现产业化	国内先进	接入网
9	25Gbps 跨阻放大器	742.19	76.70	107.64	技术开发完成	实现产业化	国际一流	接入网、数据中心、4G/5G无线领域
10	200Gbps PAM4 线性收发芯片预研	3,150.00	82.09	124.79	芯片样片阶段	实现产业化	国内先进	数据中心、AI 算力领

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
								域
11	50Gbps 突发模式 DML 驱动器芯片	2,320.00	321.23	495.65	芯片设计阶段	实现产业化	国内先进	接入网
12	2.5Gbps 对称 PON 向下兼容 GPON 收发合一芯片	1,063.00	201.90	307.42	样品阶段	实现产业化	国内领先，国际先进	接入网
13	PON ONU 控制芯片	940.00	226.88	251.71	芯片设计阶段。已初步完成关键功能模块的电路设计。	实现产业化	业内领先	接入网
14	XGS/XG-PON 突发模式跨阻放大器	590.00	82.27	89.36	样品阶段	实现产业化	国内先进	接入网
15	高动态性能数模转换器芯片预研	643.16	195.78	506.23	持续开发	技术预研	国际一流	激光雷达、传感领域
16	4x56Gbaud PAM4 线性跨阻放大器芯片	1,389.60	21.27	61.01	持续开发	实现产业化	国内一流	数据中心、AI 算力领域
17	4x112GBaud PAM4 跨阻放大器芯片预研	661.90	157.09	357.52	持续开发	技术预研	国内领先	数据中心、AI 算力领域
18	10Gbps 用户端对称突发模式收发合一芯片	218.10	8.82	8.82	芯片设计阶段	实现产业化	国内领先，国际先进	接入网
19	200Mbps 限幅放大器	173.10	22.67	22.67	芯片设计阶段	实现产业化	国内领先，国际先进	接入网、数据中心、4G/5G 无线领域
20	25Gbps 高性能带双 CDR 单模收发合一芯片	1,057.00	148.05	148.05	芯片设计阶段	实现产业化	国内领先	接入网、数据中心、4G/5G 无线领域
21	光相控阵驱动器预研	305.30	94.94	94.94	持续开发	技术预研	国际先进	激光雷达、传感领域
22	8×112GB NPO 驱动器与跨阻放大器预研	793.94	16.60	16.60	芯片设计阶段	技术预研	国内领先	数据中心；AI 算力领域
23	4×64GBaud 相干驱动器与跨阻放大器芯片	929.69	2.91	2.91	芯片设计阶段	实现产业化	国内领先	骨干网，数据中心
24	256GB 相干驱动器与跨	1,064.71	5.08	5.08	芯片设计	技术预	国内领	数据中心；

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	阻放大器芯片预研				阶段	研	先	AI 算力领域
合计	/	34,658.29	3,616.68	14,040.08	/	/	/	/

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，募集资金进度与原计划基本一致，基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

公司无控股股东，实际控制人为柯炳彝、柯腾隆。本期公司由董事会审计委员会承接监事会的法定职权，未设监事会或者监事。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	2026 年 6 月末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	质押、冻结及减持情况
柯炳彝	董事长	2024 年 4 月 20 日	2027 年 4 月 19 日	6,552,149	6,552,149	-	/	无

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	2026年6月末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	质押、冻结及减持情况
柯腾隆	董事、总经理	2024年4月20日	2027年4月19日	-	-	-	/	无
陈涵霖	董事	2024年4月20日	2027年4月19日	4,789,653	4,789,653	-	/	无
罗路	董事	2024年4月20日	2027年4月19日	-	-	-	/	无
王佐	董事	2024年4月20日	2027年4月19日	-	-	-	/	无
曾裕峰	董事	2024年4月20日	2027年4月19日	-	-	-	/	无
刘用铨	独立董事	2024年4月20日	2027年4月19日	-	-	-	/	无
邓乃文	独立董事	2024年4月20日	2027年4月19日	-	-	-	/	无
周剑扬	独立董事	2024年4月20日	2027年4月19日	-	-	-	/	无
林永辉	副总经理、核心技术人员	2024年4月20日	2027年4月19日	-	-	-	/	无
林少衡	总工程师、核心技术人员	2024年4月20日	2027年4月19日	-	-	-	/	无
陈哲	副总经理、核心技术人员	2024年4月20日	2027年4月19日	-	-	-	/	无
林智	副总经理	2024年4月20日	2027年4月19日	-	-	-	/	无
刘伯坤	副总经理	2024年4月20日	2027年4月19日	-	-	-	/	无
杨霞	董事会秘书、财务总监	2024年4月20日	2027年4月19日	-	-	-	/	无
合计	/	/	/	11,341,802	11,341,802	-	/	/

除上述情况外，公司实际控制人、董事及高级管理人员不存在其他质押、冻结及减持情况。

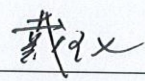
十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

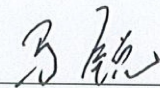
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于厦门优迅芯片股份有限公司 2026 年半年度持续督导跟踪报告》之签署页)

保荐代表人：



戴五七



马 锐

